## <<电子产品工艺>>

#### 图书基本信息

书名:<<电子产品工艺>>

13位ISBN编号: 9787121054136

10位ISBN编号:7121054132

出版时间:2008-2

出版时间:电子工业

作者:龙立钦,范泽良主

页数:199

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<电子产品工艺>>

#### 内容概要

本书是电子类中等专业学校专业课教材,内容包括电子材料,电子元器件,印制电路板设计与制作,焊接工艺,电子产品装配工艺,表面组装技术,电子产品调试工艺等。

并利用x——118型超外差式收音机进行装调实例介绍。

本书突出理论联系实际,着重介绍新知识、新技术、新工艺和新方法,强调内容实用性、针对性, 注重培养学生的实际应用和实际操作能力,内容叙述力求深入浅出、图文并茂、通俗易懂,内容编排 力求简洁明快、形式新颖、目标明确。

为了方便教师教学,本书还配有电子教学参考资料包(包括教学指南、电子教案和习题答案),详

### <<电子产品工艺>>

#### 书籍目录

第1章 电子材料 1.1 导电材料 1.1.1 导电材料的特性 1.1.2 高电导材料 1.1.3 高电阻 材料 1.1.4 导线 1.1.5 焊接材料 1.1.6 敷铜板 1.2 绝缘材料 1.2.1 绝缘材料的特性 1.2.2 有机绝缘材料 1.2.3 无机绝缘材料 1.3 磁性材料 磁性材料的特性 1.3.1 1.3.2 软磁材料 1.3.3 硬磁材料 本章小结 习题1第2章 电子元器件 2.1 电阻器 2.1.1 固定电阻器 2.1.2 可变电阻器 2.1.3 敏感电阻器 2.2 电容器 2.2.2 可变电容器 2.3 电感器 2.3.1 电感线圈 2.3.2 变压器 2.4 半导体器件 2.4.2 半导体二极管 2.4.3 半导体三极管 2.4.1 半导体器件的命名方法 2.4.4 集成电 2.5.3 有 路 2.5 表面组装元器件 2.5.1 表面组装元器件的特点 2.5.2 无源元件(SMC) 源器件(SMD) 2.6 其他常用器件 2.6.1 压电器件 2.6.2 电声器件 本章小结 实训项目:电子元器件的检测第3章 印制电路板设计与制作 3.1 印制电路板(PCB)设计基 題2 3.1.1 印制电路的基本概念 3.1.2 印制焊盘 3.1.3 印制导线 3.2 印制电路的设计 3.2.1 PCB设计流程 3.2.2 PCB设计应遵循的原则 3.2.3 计算机辅助设计介绍 3.3 印制电 路板的制作工艺 3.3.1 印制电路板原版底图的制作 3.3.2 印制电路板的印制 3.3.3 印制 电路板的蚀刻与加工 3.3.4 印制电路板质量检验 3.4 印制电路板的手工制作、 3.4.1 涂漆 3.4.2 贴图法 3.4.3 刀刻法 3.4.4 感光法 3.4.5 热转印法 本章小结 习题3 实训项目:印制电路板的手工制作第4章 焊接技术 4.1 焊接基础知识 4.1.1 焊接的分类及特 点 4.1.2 焊接机理 4.1.3 锡焊的必要条件 4.2 手工焊接技术 4.2.1 焊接工具 4.2.2 手工焊接方法 4.2.3 无锡焊接方法 4.3 自动焊接技术……第5章 装配准备工艺第6章 电子产品 装配工艺第7章 表面组装技术(SMT)第8章 电子产品调试工艺第9章 X-118型超外差式收音机装 调实例参考文献

## <<电子产品工艺>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com